

盈方微电子股份有限公司关于 本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告

经过多年在集成电路设计领域的技术积累和消费电子市场的深耕细作，盈方微电子股份有限公司（简称“公司”）已发展成为国内领先的基于智能处理器的系统级集成电路设计与软件服务提供商，在移动智能终端和智慧家庭等领域的主控芯片设计与软件开发方面具有深厚积淀。通过本次募集资金，公司将获得未来2-3年内的发展资金，用于完善研发体系和整合产业资源，从而具备提供芯片设计、软件开发和系统集成整体解决方案的能力，成为面向移动互联网、物联网、云计算服务多领域应用的平台型企业。

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集的资金总额为不超过23亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。本次募集资金将用于深化与拓展主营业务，包括完善研发体系和整合产业资源等方面，以及与之相关的日常营运资金。上述资金募集将有效地满足未来2-3年公司的发展与转型。

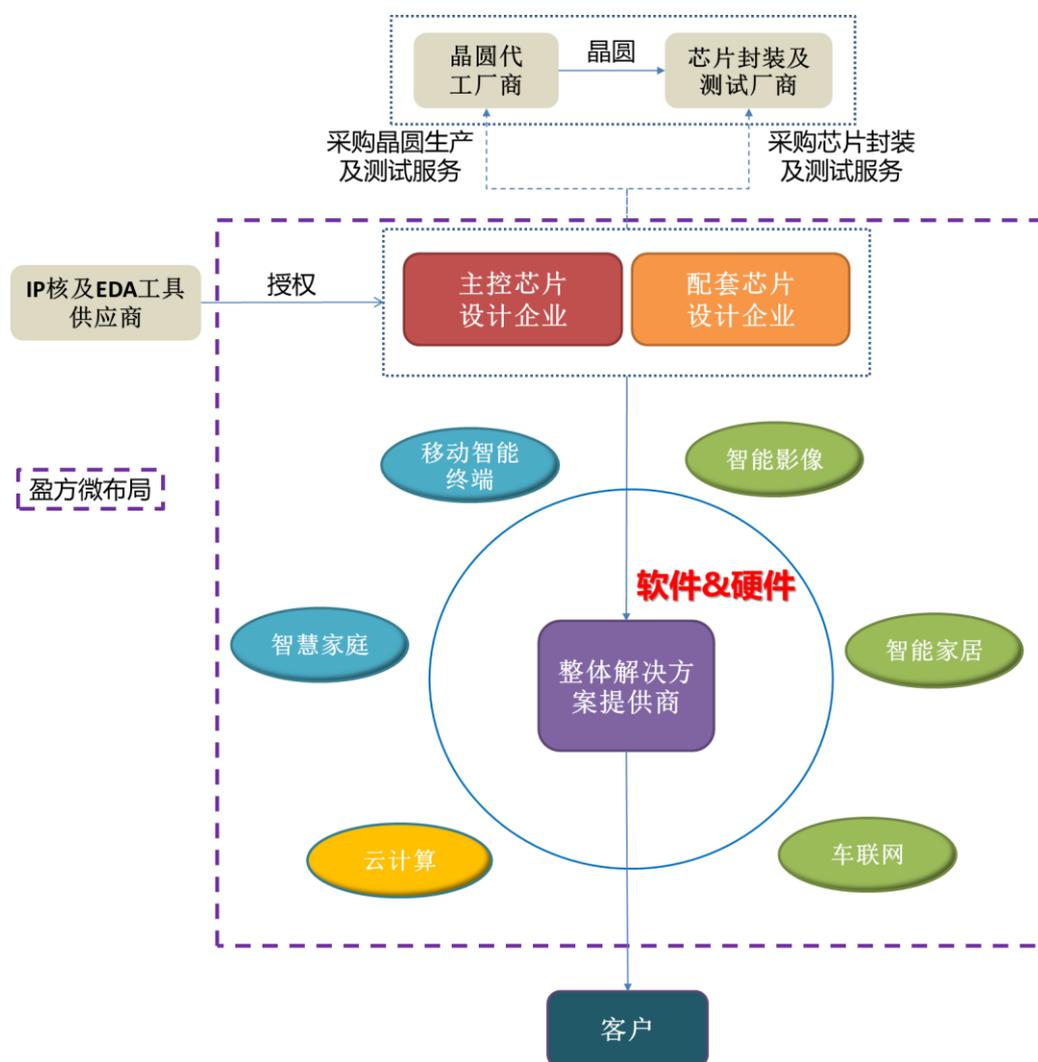
二、本次募集资金的必要性分析

当前，以移动互联网、物联网、云计算等为代表的新一代信息通信技术技术进步与模式创新活跃，整体发展势头迅猛，互相渗透联系紧密，为我国集成电路设计产业的不断升级进步创造了强大推动力。公司希望凭借在集成电路设计领域技术与市场优势，通过提升软件开发和系统集成能力，具备整合终端应用的整体解决方案提供能力，实现业务向下游移动互联网和物联网领域延伸和扩展，在移动智能终端、智慧家庭、智能影像、智能家居和车联网等重点应用方面取得突破。同时，公司将利用在此过程中积累的硬件及数据资源，搭建云计算服务平台，为客户提供全方位的服务。

公司将打造以紧贴市场发展、满足客户需求为导向的产业结构，选择面向移动互联网、物联网、云计算服务领域的多项应用为重点发展方向，定位以主

控芯片设计为基础，融合配套芯片设计，具备软件应用开发与系统集成能力的整体解决方案提供商，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台。

盈方微垂直一体化产业平台



公司未来的资金支出将围绕“盈方微产业平台”的构建与完善，主要用于下述方面：首先，从研发团队与研发中心建设入手，加强芯片设计、软件开发和系统集成的研发能力，进一步夯实公司技术基础；其次，围绕“盈方微产业平台”的各关键要素，进行产业整合，强化整体解决方案能力。此外，在公司业务转型与整体规模持续扩大过程中需投入一定营运资金，维持公司日常运作需要。

1、完善研发体系，夯实技术基础

从方向上来讲，公司未来研发投入主要集中在基于系统集成的芯片设计和软

件应用开发两个层面：

（1）芯片设计研发

芯片是智能终端的核心器件，智能终端功能的实现依赖于芯片的运行，其处理速度、功耗、软硬件协同能力等核心指标直接影响终端用户的体验和感受。而随着公司未来在配套芯片模块的布局、应用领域的延伸及云计算服务的拓展，公司需加大芯片研发投入，以适应触角更加广泛的业务需要。

因芯片产业更新迭代快，需要公司对芯片的设计工艺、视频处理、多核集成、系统总线、处理器主频等关键性能指标进行持续的技术升级，而芯片设计又具有一定的研发周期，资金投入较大，特别是在试投片生产阶段，公司需要耗费大量的费用进行光罩和试投片。鉴于芯片产业更新迭代快、设计研发周期长和市场需求不断变化的特点，公司的研发需要基于市场预判有一定的前瞻性，提前进行相关布局和技术储备。

此外，将芯片研发技术成果模块化，形成自主IP（Intellectual Property）核等专有技术，有利于为客户提供个性化和差异化服务，同时模块化设计可有效降低资金和时间成本。公司目前自主研发了总线架构设计、电源管理架构设计、存储架构设计、芯片诊断设计、图形加速、图像信号处理、加解密引擎、外设接口控制等芯片核心技术，未来将加快模块化进程，建立独具特色的自有IP核体系。

目前，公司已研发和量产了iMAPx2、iMAPx8、iMAPx15、iMAPx9等四大系列移动智能处理器芯片。未来随着业务的延伸，公司将进一步研发满足终端用户需求的通用及专用芯片，并着手开展服务器芯片的研发工作，以带动云计算服务平台的建设。

（2）软件开发

随着终端消费者对用户体验的要求越来越高，整个行业在大力提升芯片硬件水平的同时，也更加注重配套软件的研发和优化，使其更好地与芯片功能相适应并有效满足用户需求。

与芯片相关的软件开发主要包括操作系统，底层软件、驱动程序、中间件软件、第三方软件以及应用程序的开发与优化。其中，公司在底层软件、驱动程序

和中间件软件的开发与优化领域具有较强的技术积累，形成自主研发能力。

公司未来将针对移动互联网、物联网、云计算服务领域的多项应用，加强软件开发投入，并进一步形成操作系统和应用程序的自主开发能力，从而实现软硬件的有机结合，提升自身系统集成能力，加快向整体解决方案提供商的转型。

具体来讲，未来公司研发投入将体现在以下几个方面：

首先，公司将加强研发团队建设，建立人才引进机制，积极引进国内外高层次技术人才，并借助产学研合作平台及人才储备计划等方式进行人才培养。公司将不断完善绩效考核体系和激励机制，全面激发研发人员的工作积极性和创新性，使研发人才队伍进一步满足公司快速发展的需要。

其次，公司将在现有研发机构的基础上，扩大规模并进行技术升级，建立与公司技术水平和行业地位相适应的研发中心，全面提升公司技术研发的深度、广度和速度，不断跟踪市场变化和技术发展。

第三，日常研发过程中需要的IP的授权、光罩制作、晶圆生产及测试、芯片封装及测试等环节，公司外包给专业厂商完成，需要进一步投入资金进行相关技术服务采购。

2、整合关键要素，搭建产业平台

公司希望通过资源整合，形成更全面的产品线、更丰富的应用功能、更强的系统集成能力，从而增加产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。公司将通过并购、投资和业务协同等多种方式对产业链的各主体进行整合，从而使从事芯片设计和应用开发的其他企业参与平台发展，发挥协同与聚集效应，实现产业链整体价值的最大化。

未来整合主要包括芯片层面的整合和应用层面的整合两个方向。

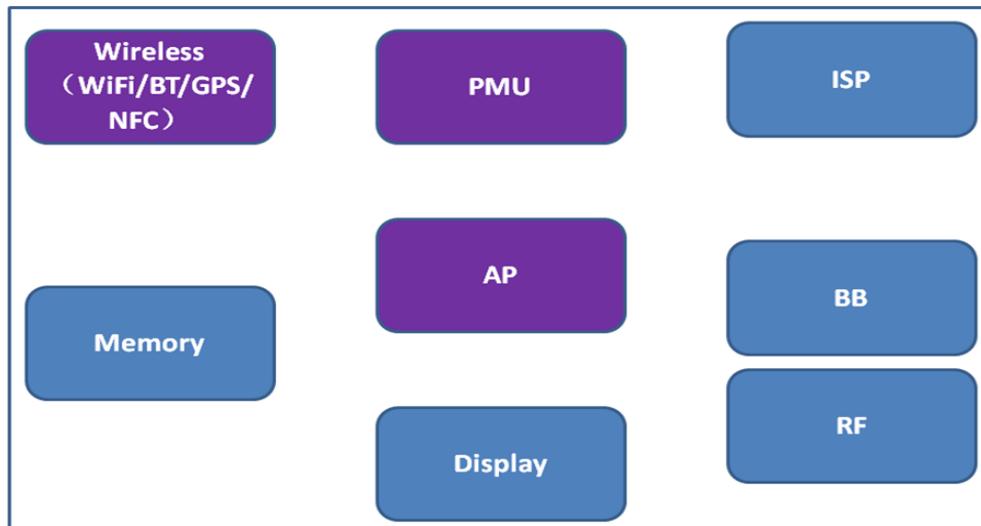
(1) 芯片层面的整合

主控芯片负责运算和控制，是协调主板上其他配套芯片的渠道和桥梁，在芯片层面具有核心地位，具备整合其他配套芯片的天然优势。而通过整合其他配套芯片，主控芯片设计企业可以提供集成度更高、功能更强大的产品，从而顺应产

业发展趋势，满足不断提升的市场需求。

针对公司未来重点布局的移动互联网与物联网领域，无线通讯与电源管理为其中的关键环节。无线通讯相关芯片的性能决定了传输速度与流畅度等关键指标，是实现人人、人机、机机互联的基础。电源管理芯片在传统集成多路转换器的基础上，增加了通路管理、电池电量计算以及动态功耗管理功能，能够实现更高的系统转换效率和更低的系统动态功耗，可延长智能终端的电池续航时间。

智能终端主板布局



注：主控（AP）芯片属于系统级芯片，负责运算和控制，是主板上必不可少的组成部分。其他的芯片主要包括：无线（Wireless）芯片、电源管理（PMU）芯片、图像信号处理（ISP）芯片、内存（Memory）芯片、显示（Display）芯片、基带处理器（BB）芯片和射频（RF）芯片，均为实现某项功能的配套芯片。

（2）应用层面的整合

为形成垂直产业链，公司业务需向下游延伸，以应用为纽带更紧密地与客户建立联系。公司将依托芯片设计优势，整合服务器硬件资源，拓展提供云计算服务的平台运营能力。

结合公司现状和对未来市场的预判，针对包括移动智能终端、智慧家庭、智能影像、智能家居、车联网在内的移动互联网和物联网等领域应用开发的公司和云计算服务公司是重点整合方向。

综上所述，公司未来在研发和整合等方面的投入有助于公司打造垂直一体

化的产业平台。募集资金到位后，公司的资金需求将得到较大程度的满足，并结合更加有效的业务模式产生更高的边际效应。

三、本次募集资金的可行性分析

1、突出的技术优势和深刻的市场理解使公司具备产业延展的客观条件

首先，公司为我国领先的系统级集成电路设计企业，具备模块化设计能力，在图像显示、图像信号处理、功耗及主频等决定处理器性能的关键指标方面具有突出的技术优势。而主控芯片作为智能终端的核心技术单元，起到运算和控制的作用，公司以主控芯片设计及相关软件开发为基础向其他功能芯片设计与软件开发及系统集成延展具有较强技术可行性。

其次，公司为国内较早从事智能产品处理器研发和销售的芯片设计企业，且始终专注于该领域，对以市场需求为导向的开发模式有着深刻的理解，并建立了与市场高度协调的产销模式。对市场的敏锐判断保证了公司在开拓业务的过程中能够精准把握市场方向，重点布局。

第三，公司在发展过程中，与ARM公司、Synopsys公司等知名IP核及EDA工具供应商以及创意电子、台积电等世界级的晶圆代工、封装及测试企业建立了紧密的合作伙伴关系，具有较强产业链协同优势。这为公司在未来业务拓展中的产品质量和供货效率提供了扎实保证。

2、上市平台打通公司发展的资本纽带

上市平台为公司后续发展业务与实施产业整合提供了资本运作手段。公司可借助资本市场，获取支持主营业务的资金与实施外部收购的高效手段，并通过资本纽带打通公司产业平台的各个环节，充分发挥协同与产业聚集效应。

3、政策支持与产业进步为公司实施整合创造了良好的外部环境

集成电路产业为战略性基础产业，国家出台了一系列有关集成电路行业的法律法规和产业政策，使得国内集成电路产业环境不断完善、市场更加规范。特别是国务院于2014年6月发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出重点发展集成电路设计行业，聚焦移动智能终端和网络通信领域，以设计业的快速增长

带动制造业的发展，并发挥市场机制作用，引导和推动集成电路设计企业兼并重组。而移动互联网、物联网、云计算为集成电路设计的重点应用方向，其快速增长进一步推动了集成电路设计产业的进步与升级。

就集成电路设计产业态势而言，经过多年发展，国内行业规范程度较高，技术积累已达一定水平，出现了一批在移动互联网、物联网和云计算领域具有较高芯片设计和应用开发能力的企业。随着公司产业平台的搭建和完善，打通垂直产业链条，将有越来越多的特色企业参与这个平台的发展，并产生协同和聚集效应，实现平台企业和参与企业的双赢。

综上所述，公司突出的技术实力、对市场的深刻理解、上市公司的平台优势以及良好的外部环境为公司通过研发投入和产业整合打造垂直一体化的产业平台创造了有利条件。本次募集资金到位后，公司将解决资金瓶颈的束缚，有助于充分实施战略，并在未来**2-3**年内将公司打造成为领先的芯片设计、软件开发和系统集成的整体解决方案提供商。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

1、有利于公司构建垂直一体化的产业平台，推动主营业务快速发展

本次募集资金使用符合国家产业政策和行业规划，符合行业发展趋势。本次募集资金到位后，公司能够进一步用以提升技术水平及生产效率，增强核心竞争力，巩固和提高公司的行业地位。

2、有利于公司以更好的业绩回报股东，为长远发展打下坚实基础

本次募集资金到位后，公司的收入和利润水平将有所增长，公司盈利能力将得到较大提高。公司整体实力的增强和市场影响力的提升，将为公司未来的产业发展和资本运作打下坚实基础。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

1、降低资产负债率，增强抵御风险的能力

本次募集资金到位后将有助于公司优化资产负债结构，降低财务风险。以

2014年6月30日公司资产、负债（合并口径）为计算基础，按照募集资金23亿计算，则本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将从28.00%下降至6.81%，下降21.19个百分点。因此，本次非公开发行有利于提高公司抵御风险的能力。

2、优化收入结构

本次募集资金到位后，公司将加大垂直一体化的产业平台的建设，通过提供芯片设计、软件开发和系统集成整体解决方案，建立终端消费者对公司产品的依存度，提高软件及技术服务的收入比重，进而优化公司的收入结构。

3、提高盈利水平

本次募集资金的投入将提升公司的综合竞争实力，从而对提高盈利能力起到重要的推动作用。充裕的流动资金有助于公司顺利实施战略规划，进一步提高公司的市场地位，公司收入规模和利润水平都将出现较大幅度的增长。

4、改善现金流状况

本次募集资金到位后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加。随着募集资金到位，公司偿债能力将有所增强，筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加，有助于满足公司的发展需求。随着募集资金的使用效益逐步产生，未来经营活动现金流入和流出将大幅增加。

五、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金，不涉及募集资金投资项目报批事项。

综上所述，本次公司运用募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规，符合公司的实际情况和发展需求。本次非公开发行将进一步壮大公司的实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十五日